

1										2										3										4																																												
A B										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">수 정 내 용</th> </tr> <tr> <td>ST</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>부호</td> <td>내 용</td> <td>수정자</td> <td>승인자</td> <td>년 월 일</td> </tr> <tr> <td>ST(기준)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ST(개선)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										수 정 내 용										ST										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	ST(기준)										△					ST(개선)										△				
										수 정 내 용																																																																
										ST										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일																																																		
ST(기준)										△																																																																
ST(개선)										△																																																																

6	RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
5	PIPE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00014-1345/1 (FB002)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00903-N/1 (HB001)
3	PIN	1	P B R	Gold Plate	DCT00957-135/1 (EB005)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01172-135/1 (DB003)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01173-1345/1 (DB007)

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	±0.1	년월일 1992. 7. 16.			KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
.*	±0.05	승인					
재질		감도			도명 KJD-R75-5		
열처리		재도					
보호피막처리		작성부서			A4 도번 CN00650-7/1		
		연 구 소					
		적도 NS	단위 mm	총량	K385-264-000		